

Rework-Spitze RxP Serie Tunnel für SOIC-8, Breite 2,29 mm - Oki RCP-DL2

Artikel-Nr. **WL28013**Hersteller **Oki**

Tunnelförmige Rework-Spitze der RxP Serie für SOIC-8-Bauteile, geeignet für Keramik und Anwendungen mit hohen thermischen Anforderungen geeignet. Passt auf das MFR-Handstück MFR-H1-SC der MFR-1100 und MFR-2200 Systeme.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	Vereinigte Staaten
Zolltarifnummer	85159080900

Kein Produktbild

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Die tunnelförmige Rework-Spitze RCP-DL2 der RxP Serie umschließt SOIC-8-Gehäuse und entlötet alle Anschlüsse in einem Arbeitsgang. Sie ist für Keramik und Anwendungen mit hohen thermischen Anforderungen ausgelegt.

VORTEILE

- SmartHeat Technologie der Metcal MFR-Plattform hält die Spitzentemperatur ohne Kalibrierung konstant
- Spitzenbreite 2,29 mm, Spitzen-Maße 5,18 x 4,23 mm
- Werkzeuglos wechselbar am Handstück MFR-H1-SC

ANWENDUNGEN

Reparatur und Nacharbeit elektronischer Baugruppen, für Keramik und Anwendungen mit hohen thermischen Anforderungen geeignet.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Passendes Handstück: MFR-H1-SC. Geeignet für die Oki MFR-1100 und MFR-2200 Systeme. Lieferung als Einzelstück.

RoHS-konform, ESD-gerecht nach IEC 61340-5-1. Herkunft: USA.